

# Summit 1800i

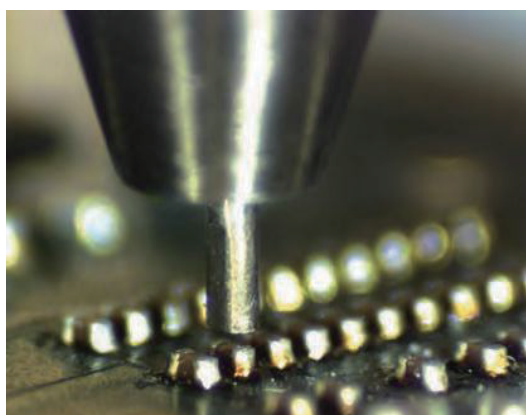
## 半自动返修系统

Summit 1800i 是广受欢迎的 Summit 系列的最新产品。它传承了该系列卓越的加热性能、高产能和可靠性、可重复性，并提供了更优越的性能和灵活性。

改良设计的元件贴放为微型无源器件和连接器提供了更好的返修性能。最大达 80mm 的视野，使 Summit 1800i 能够满足现今和未来许多年的返修需求。



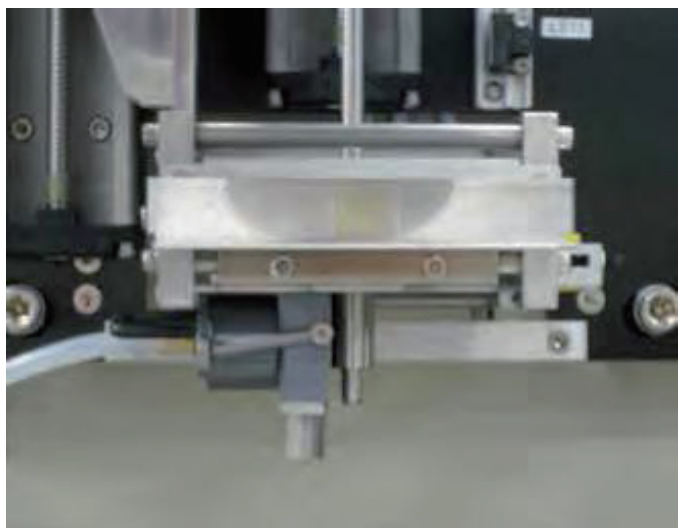
Summit 1800i



01005 返修

### 主要性能特点

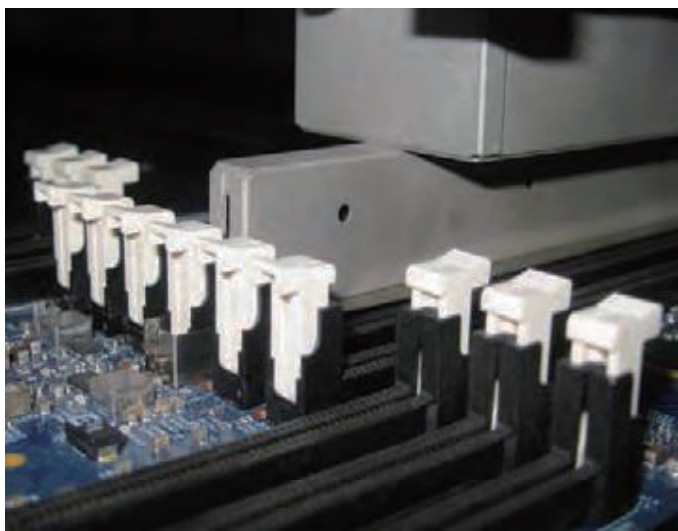
- 贴片精度 – 0.005" (12μ)
- 顶部加热器 – 1.6kW热风对流加热
  - 2.2kW高效顶部热风对流加热器
- 底部加热器 – 4.0kW热风对流加热
  - 可选配7.8kW底部热风对流加热器
- 最大电路板尺寸
  - 标配18 x 22" (455 x 560 mm)
  - 选配22 x 30" (560 x 760 mm)



带有动态高度感应的除锡器  
自动化非接触式除锡



1-2-3-Go 操作员图形用户界面



对排列紧密的连接器进行返修

Summit 1800i 是首屈一指的表面贴装返修系统。它不仅结合了所有 Summit 系统共有的声誉卓著的功能及优点，还引入了最先进的创新技术，可满足最新的行业进步和技术要求。

### 标配功能：

- 可自动生成温度曲线的SierraMate软件
- 便于使用的“1-2-3-Go”用户界面
- 独立的热风对流加热器及元件拾取动作
- 精确的贴片性能，贴片力度可编程
- 顶部加热器冷却加速及主动元件冷却
- 零压力元件移除
- 6个用户热电偶输入接口

### 广受欢迎的选配功能：

- 带有动态高度感应的可编程除锡器
- 22 x 30"电路板支撑平台，带有7.8kW底部加热器
- 1000W底部热风对流加热器
- >80mm对位视野
- 元件锡膏印刷工具